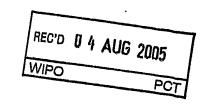
特許協力条約



特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]



出願人又は代理人 の哲類記号 AY04-0224W01	今後の手続きについては、様式PCT	/IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2004/006144	国際出願日 (日. 月. 年) 28. 04. 2004	優先日 (日.月.年) 15.07.2003
国際特許分類(IPC) Int.Cl. ⁷ H01L21/20	03, C30B23/08, H01L21/338, 29/778, 2	9/812
出願人 (氏名又は名称) 株式会社日鉱マテリアルズ		
 この報告書は、PCT35条に基づき、法施行規則第57条 (PCT36条)の この国際予備審査報告は、この表紙を この報告には次の附属物件も添付される。 ア 附属書類は全部で 1 	の規定に従い送付する。 と含めて全部で 3 ペー れている。	•
 ✓ 補正されて、この報告の基件 囲及び/又は図面の用紙() 「 第 I 欄4. 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定した b. 「 電子媒体は全部で 	礎とされた及び/又はこの国際予備審査 PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号 したように、出願時における国際出願の た差替え用紙	機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範参照) 開示の範囲を超えた補正を含むものとこの (電子媒体の種類、数を示す)。 式による配列表又は配列表に関連するテー
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	·合む。	
! 第17個 発明の単一性の	E又は産業上の利用可能性についての国際 ク欠如 に規定する新規性、進歩性又は産業上の R及び説明 「献	発予備審査報告の不作成 利用可能性についての見解、それを 娶 付
国際予備審査の請求書を受理した日 08.03.2005	国際予備審査報告 25.	を作成した日 07.2005
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP)	特許庁審査官(権 橋本 嶽一	

電話番号 03-3581-1101 内線 3471

郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号

第I橌	報告の基礎		
າ. ະ ວ	国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほ	か、国際出願の言語を基礎とした。	
 	この報告は、 語による翻訳文を それは、次の目的で提出された翻訳文の言語では PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 PCT規則12.4にいう国際公開 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審理	と基礎とした。 ある。 :	
2. この h ****)報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6 え用紙は、この報告において「出願時」とし、こ	条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために数 の却告に派付していない。)	是出され
に定省が	と出紙は、この報告において「山ヶ崎」とし、この報告において「山ヶ崎」とし、この報告において「山ヶ崎」とし、この報告において「山ヶ崎」とし、このは、	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
,		•	
∀	第 1 - 9 ペーシ	ジ、出願時に提出されたもの ジ*、 付けで国際予備審査機関が受理 ジ*、 付けで国際予備審査機関が受理	したもの したもの
1		1177 (1177 (1177) 1177) 1177 117	
,,	第 <u>3,4</u> 第	頁、 出願時に提出されたもの 頁*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 頁*、 <u>08.03.2005</u> 付けで国際予備審査機関が受理 頁*、 付けで国際予備審査機関が受理	!したもの !したもの
I	part part		
		図 、 出願時に提出されたもの 図 *、 付けで国際予備審査機関が受理 図 *、 付けで国際予備審査機関が受理	担したもの 担したもの
з. Г	配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。 補正により、下記の審類が削除された。	·	
	丁 明細書 第	ページ	
1	請求の範囲 第 図面 第 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体的に記述すること)	型域すること) 項	<u>-</u>
4. Г	- この報告は、補充欄に示したように、この報 えてされたものと認められるので、その補正	g告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示。 Eがされなかったものとして作成した。(PCT規則 70.2(c)	の範囲を) ・
		ページ	
·	「 請求の範囲 第 <u> </u>	項 ページ/図	
	一 配列表に関連するテーブル(具体的に	記載すること)	
	に該当する場合 その用紙に "superseded"	Long data was ladda w	

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/006144

. 見解		
新規性(N)	請求の範囲 <u>1-4</u> 請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-4</u> 請求の範囲	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1 - 4</u> 請求の範囲	

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献 1: JP 7-86162 A(株式会社日立製作所), 1995.03.31 文献 2: JP 6-97097 A(日本電気株式会社), 1994.04.08

請求の範囲 1-4 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩

性を有する。 文献1,2には、III 族元素および第1のV族元素の分子線の照射を停止し、第1の 文献1,2には、III 族元素および第1のV族元素の分子線の照射を停止し、第1の V 族元素の供給量が 1/10 以下となるまで成長を中断した後にエッチストッパ膜を成長させ、エッチストッパ膜のエッチング耐性を向上させることについては、記載も示 唆もされていない。

請求の範囲

- 1. (補正後)分子線エピタキシャル成長法により I I I ーV族系化合物半導体のヘテロ接合を有する半導体薄膜を形成するエピタキシャル成長方法であって、
- 5 少なくとも一種類以上のIII族元素の分子線と第1のV族元素の分子線とを 照射して第1の化合物半導体層を形成する第1の工程と、

前記III族元素の分子線と前記第1のV族元素の分子線の照射を停止し、前記第1のV族元素の供給量が前記第1の工程における供給量の1/10以下となるまで成長を中断する第2の工程と、

10 少なくとも一種類以上のIII族元素の分子線と第2のV族元素の分子線とを 照射して前記第1の化合物半導体層上に前記第1の化合物半導体とは異なり第2 の化合物半導体層からなるエッチストッパー層を形成する第3の工程と、

を備えることを特徴とするエピタキシャル成長方法。

15 2. (補正後)分子線エピタキシャル成長法により I I I - V族系化合物半導体のヘテロ接合を有する半導体薄膜を形成するエピタキシャル成長方法であって、少なくとも一種類以上の I I I 族元素の分子線と第1のV族元素の分子線とを照射して第1の化合物半導体層を形成する第1の工程と、

前記III族元素の分子線と前記第1のV族元素の分子線の照射を停止すると 20 ともに、第2のV族元素の分子線を照射し、前記第1のV族元素の供給量が前記 第1の工程における供給量の1/10以下となるまで成長を中断する第2の工程 と、

さらに、少なくとも一種類以上のIII族元素の分子線を照射して前記第1の 化合物半導体層上に前記第1の化合物半導体とは異なる第2の化合物半導体層か らなるエッチストッパー層を形成する第3の工程と、

を備えることを特徴とするエピタキシャル成長方法。

25

3. 前記第1の化合物半導体層はInAlAs層またはInGaAs層であり、 前記第2の化合物半導体層はInP層またはInGaP層であることを特徴とす